

HY2系列导热凝胶、导热泥可塑界面材料

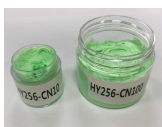
专为电子零部件降温设计的导热界面材料

項 目	HY214	HY216	HY224	HY226	HY234	HY236	HY256	單位
顏色 Color	WHITE (白)	WHITE (白)	BLUE (蓝)	BLUE (蓝)	PINK (粉)	PINK (粉)	GREEN (绿)	No
熱傳導系數 Thermal Conductivity	> 4.0	> 6.0	> 4.0	> 6.0	> 4.0	> 6.0	> 6.0	W/m-K
熱阻抗 Thermal Impedance	< 0.028	< 0.025	< 0.028	< 0.025	< 0.028	< 0.025	< 0.025	°C-in ² /W
粘度 Viscosity	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	No
密度 Specific Gravity	3.05	3.2	3.05	3.2	3.05	3.2	3.2	g/cm ³
击穿强度 Dielectric Strength	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	kv/mm
工作溫度 Operation Temperature	-20-150°C	-20-150°C	-20-150°C	-20-150°C	-20-150°C	-20-150°C	-20-150°C	°C

矽化合物 Silicone Compounds	10%	6%	10%	6%	10%	6%	6%	%
碳化合物 Carbon Compounds			1%	1%	1%	1%	2%	%
氧化金屬化合物 Metal Oxide Compound	90%	94%	89%	93%	89%	93%	92%	%

包 裝	针筒包装	罐装CN							
	30CC-300CC	10g-1000g							

产品图片



※ 本產品耐溫，不自燃，採一般室溫儲存方式即可。

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。